

2023年度（2024年3月期） 第2四半期 決算説明会

（2023/4/1～2023/9/30）

2023年度第2四半期実績及び 2023年度通期見通しについて

代表取締役社長 鷹野 準

(ご注意)

本資料中の四半期数値は特に断りがない限り、第2四半期累計期間を表示しております。

2023年度第2四半期（連結） 決算実績の内容について

（ご注意）

- ・当期（2024年3月期）より報告セグメントの区分を変更しており、過年度も当該変更を反映した数値に組替えております。
- ・前期末に企業結合において生じたのれんの金額は、取得原価の配分が完了していないため暫定的な金額です。
取得原価の配分の結果によって、のれん金額が変更になる可能性があります。

当社およびグループ会社の概要について

○：連結子会社、●：連結子会社（孫会社）

会社名	沿革等		事業の内容
※当社 タカノ株式会社	1953年7月 1997年2月	ばね製造会社として設立 東京証券取引所に上場	オフィス家具、ユニット（ばね）製品、エクステリア製品、画像処理検査装置、電磁アクチュエータ、健康福祉関連機器の製造販売
○(株)ニッコー [機械・工具]	1968年3月	グループ内の工具機械等の仕入をする商社機能として設立	工具、器具、機械、エクステリア製品の仕入販売
○タカノ機械(株) [検査計測機器]	1979年9月	当社治工具・専用機の設計製造部門を分離独立させ設立	・省力化機械の製造販売 ・検査計測装置のメカ機械等の製作
○台湾鷹野股份有限公司 [検査計測機器]	2005年2月 2005年4月	当社100%子会社として設立 営業開始	台湾におけるFPD向け画像処理検査装置のメンテナンス、アフターサービス、販売活動
○上海鷹野商貿有限公司 [住生活関連機器]	2010年1月 2013年12月	当社100%子会社として設立 資本金を50万米ドルに増資	オフィス家具他、各種製品の仕入販売（当社各部門の中国市場向けの製品の販売活動等、中国からの部材仕入活動等を行う目的で設立）
○香港鷹野国際有限公司 [産業機器]	2011年8月 2012年4月	当社100%子会社として設立 営業本格開始	産業機器（電磁アクチュエータ）製品、検査計測機器製品およびそれぞれの製品にかかる部品等の仕入・販売（輸出入）
○Takano of America Inc. [産業機器]	2019年8月 2020年4月	当社100%子会社として設立 営業本格開始	産業機器（電磁アクチュエータ）製品の仕入販売
○(株)ユーキ・トレーディング [住生活関連機器]	1989年6月 2023年3月	会社設立 株式を100%取得し連結子会社化	福祉用具・健康用品の輸出入および国内販売
●鷹野電子(深圳)有限公司 [産業機器]	2023年9月 2023年10月	香港鷹野国際有限公司の100%子会社として設立 営業本格開始	産業機器（電磁アクチュエータ）製品および部品等の仕入・販売（輸出入）

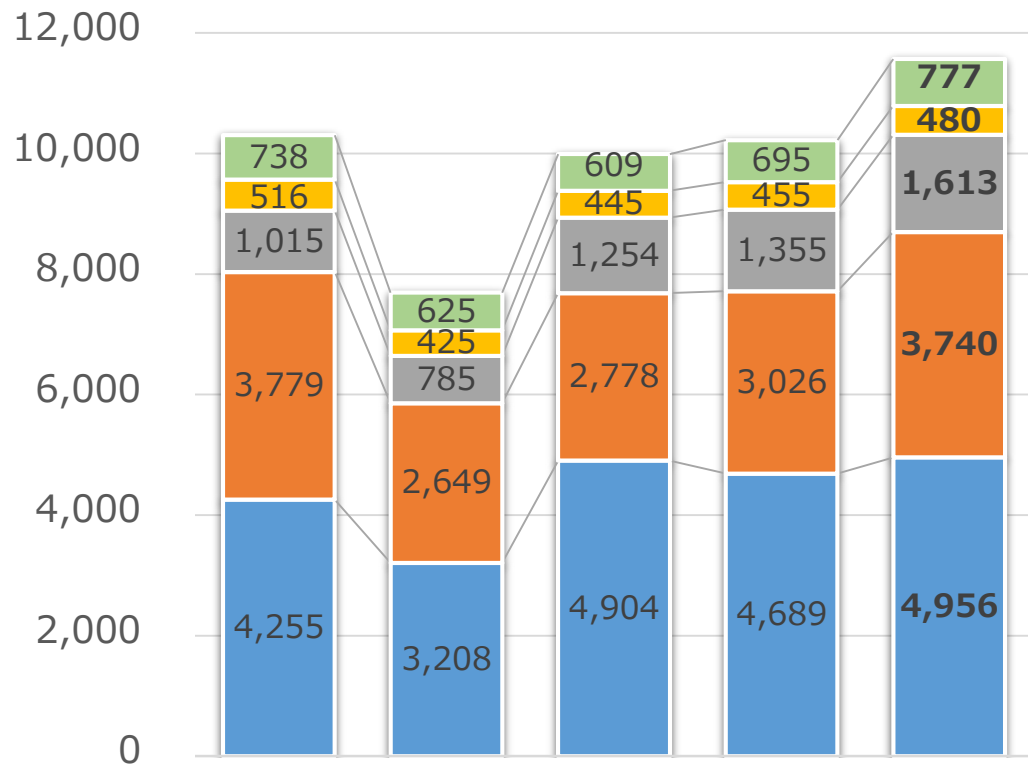
2023年度 第2四半期決算実績(対前期比)

	2022年度上期実績 (百万円)	2023年度上期実績 (百万円)	前年同期比 (%)
売上高	10,222	11,568	113.2
営業利益	201	69	34.5
経常利益	278	166	59.6
親会社株主に帰属 する四半期純利益	180	255	141.3

連結セグメント別売上高の推移

セグメント別売上高推移

単位：百万円

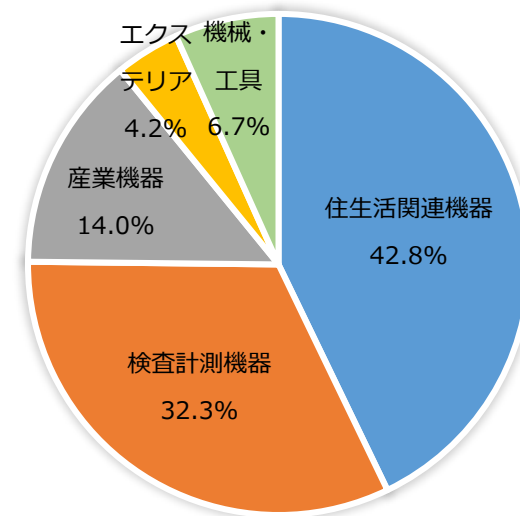


19年度上期 20年度上期 21年度上期 22年度上期 23年度上期

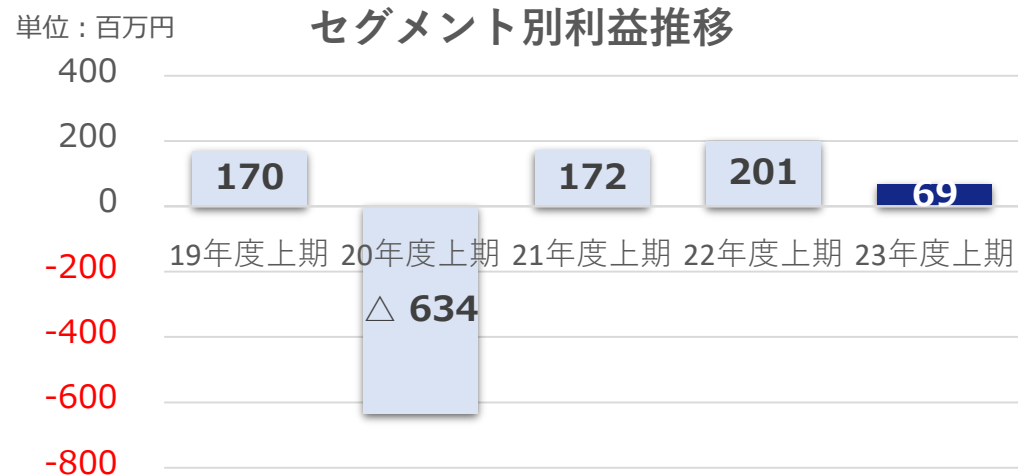
■ 住生活関連機器 ■ 検査計測機器 ■ 産業機器 ■ エクステリア ■ 機械・工具

	22年度上期実績 (百万円)	23年度上期実績 (百万円)	前年同期比 (%)
住生活関連機器	4,689	4,956	105.7
検査計測機器	3,026	3,740	123.6
産業機器	1,355	1,613	119.0
エクステリア	455	480	105.5
機械・工具	695	777	111.9
合計	10,222	11,568	113.2

2023年度第2四半期 連結売上高構成比



連結セグメント別利益の推移



【連結セグメント別利益 内訳※】

(単位：百万円)

	19年度上期	20年度上期	21年度上期	22年度上期	23年度上期
住生活関連機器	△159	△487	△50	△240	△306
検査計測機器	198	△165	△95	196	14
産業機器	66	4	278	215	303
エクステリア	34	△1	3	△0	15
機械・工具	22	18	41	30	26
取引消去	8	△3	△4	△0	16
合計(営業利益)	170	△634	172	201	69

	22年度上期実績 (百万円)	23年度上期実績 (百万円)	前年同期比 (%)
住生活関連機器	△240	△306	-
検査計測機器	196	14	7.5
産業機器	215	303	140.8
エクステリア	△0	15	-
機械・工具	30	26	84.5
取引消去	△0	16	-
合計(営業利益)	201	69	34.5

※当期（2024年3月期）より報告セグメントの区分を変更しており、
過年度も当該変更を反映した数値に組替えております。

経常損益・四半期純損益の推移



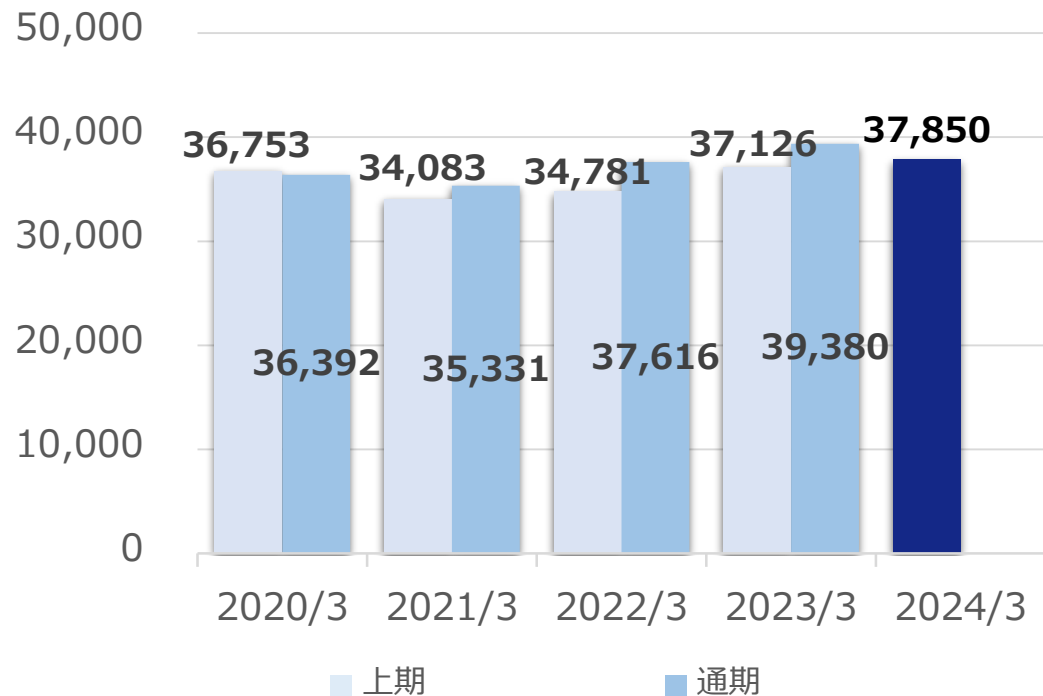
※「四半期純損益」は親会社株主に帰属する四半期純損益を表示しております。

● 2023年度第2四半期の1株当たり四半期純利益
16円79銭

総資産・純資産推移

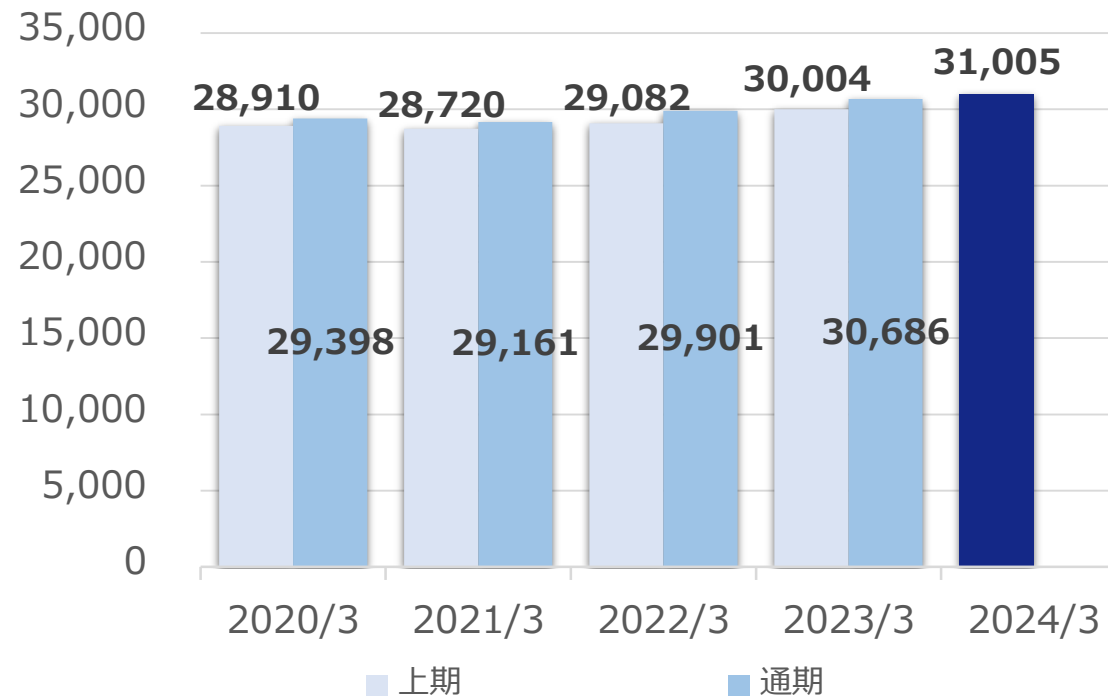
総資産

単位：百万円



純資産

単位：百万円



● 2023年9月末の自己資本比率 **81.9%**

● 1株当たり純資産 **2,036円97銭**

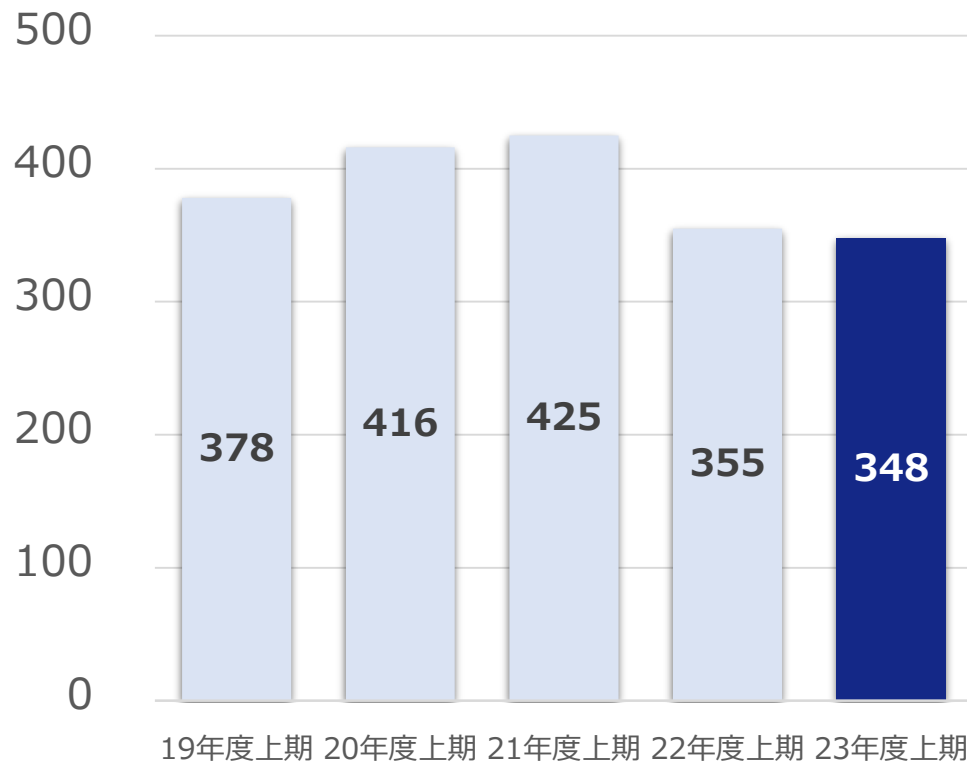
2023年度 第2四半期キャッシュ・フロー計算書

	2022年度上期実績 (百万円)	2023年度上期実績 (百万円)	前年比増減 (百万円)
営業活動によるCF	1,224	1,924	699
投資活動によるCF	△116	252	369
財務活動によるCF	△309	△343	△33
現金等換算差額	109	67	△41
現金等の増減額	906	1,900	993
現金等期首残高	7,474	7,641	167
現金等四半期末残高	8,381	9,542	1,161

研究開発の状況

研究開発費推移

単位：百万円



● 2023年度上期の主な研究開発の内容

■ 住生活関連機器

- ・ 環境対応 新素材研究等
- ・ 金属3Dプリンターを活用した開発試作
- ・ 体外診断用医薬品および診断装置開発

■ 検査計測機器

- ・ 高速・高分解能新型カメラおよび画像処理装置開発
- ・ AIによる欠陥分類研究

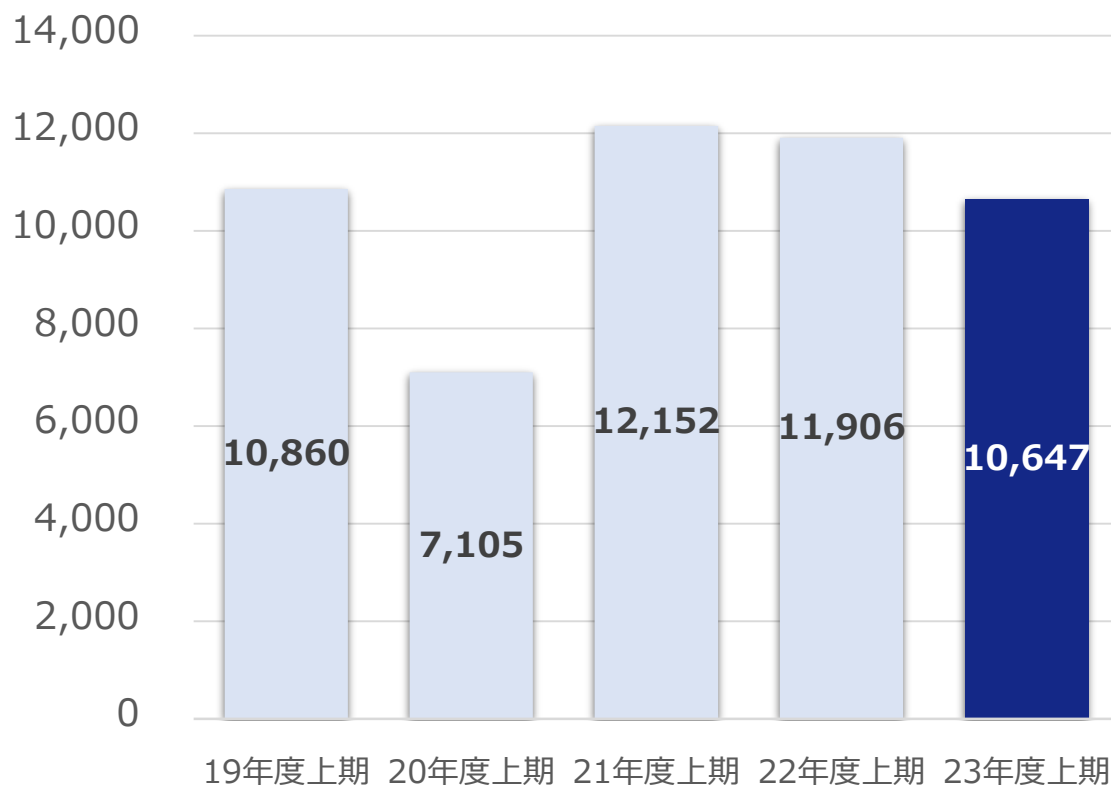
■ 新事業開発関係（基礎研究）

- ・ 医療関連機器開発
- ・ MEMS（微小電気機械システム）デバイス開発

受注・受注残高の状況

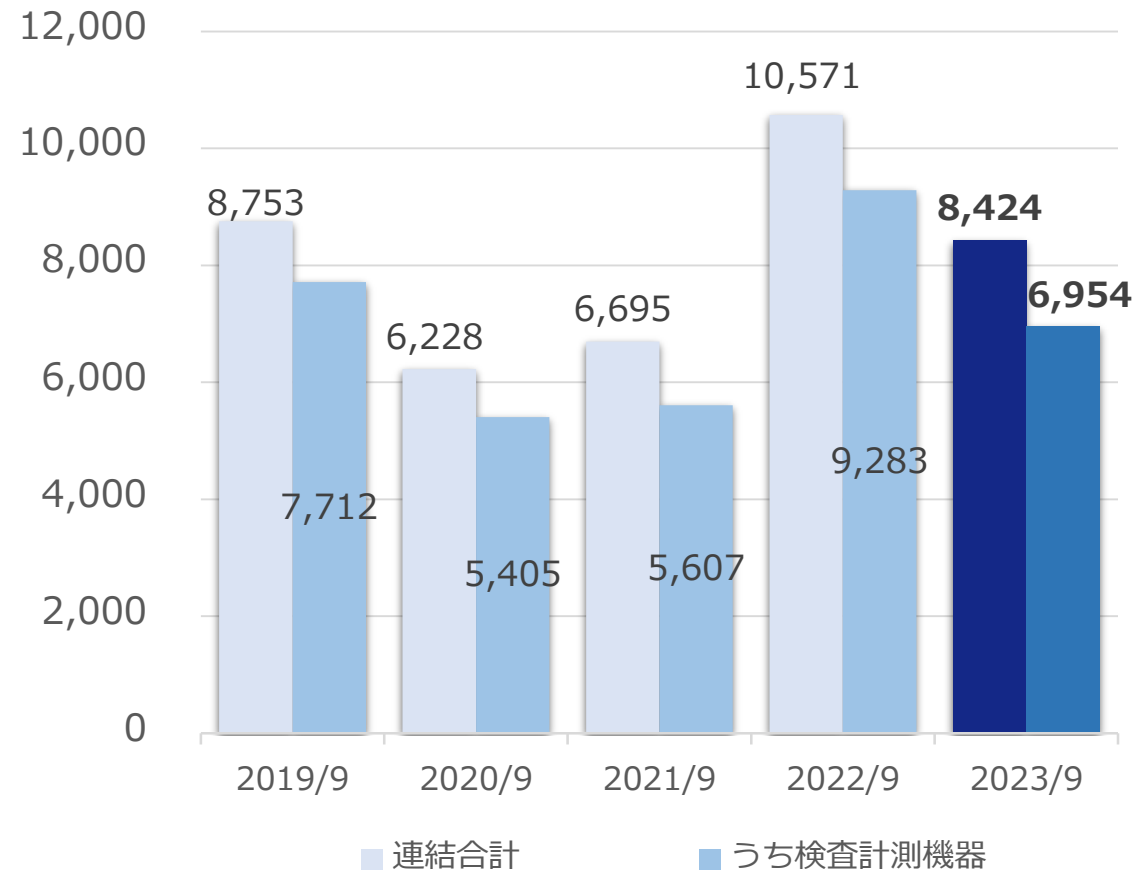
受注高推移(第2四半期累計)

単位：百万円



受注残高推移(第2四半期末)

単位：百万円

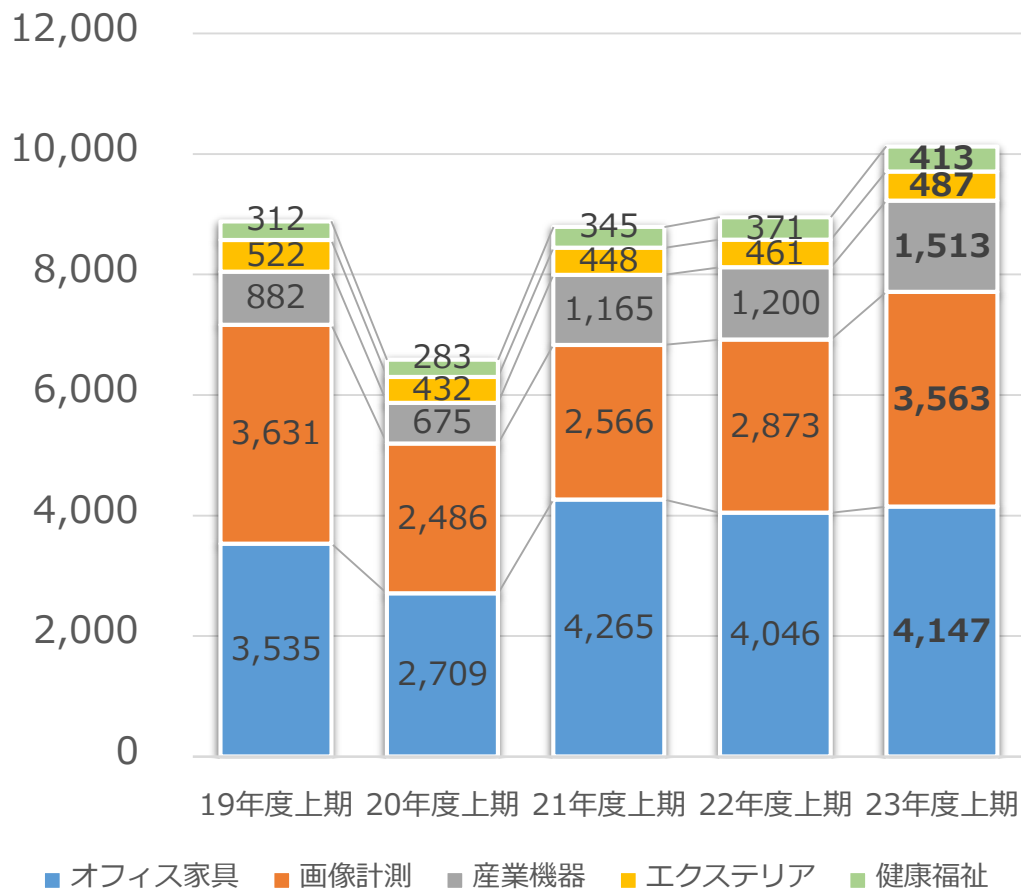


2023年度第2四半期（単独） 部門別売上高実績の内容について

事業別第2四半期売上高(単独)の推移

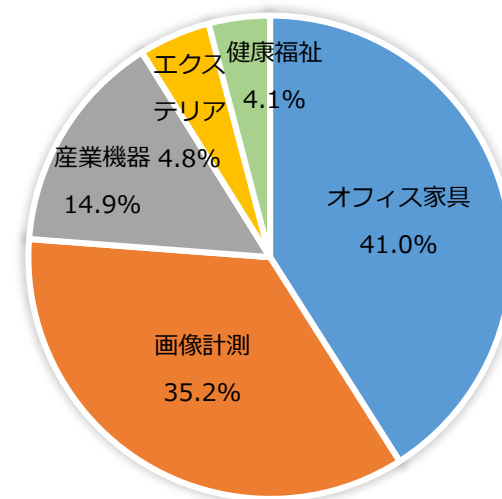
事業別売上高推移

単位：百万円



	22年度上期実績 (百万円)	23年度上期実績 (百万円)	前年同期比 (%)
オフィス家具	4,046	4,147	102.5
画像計測	2,873	3,563	124.0
産業機器	1,200	1,513	126.0
エクステリア	461	487	105.7
健康福祉	371	413	111.1
合計	8,953	10,124	113.1

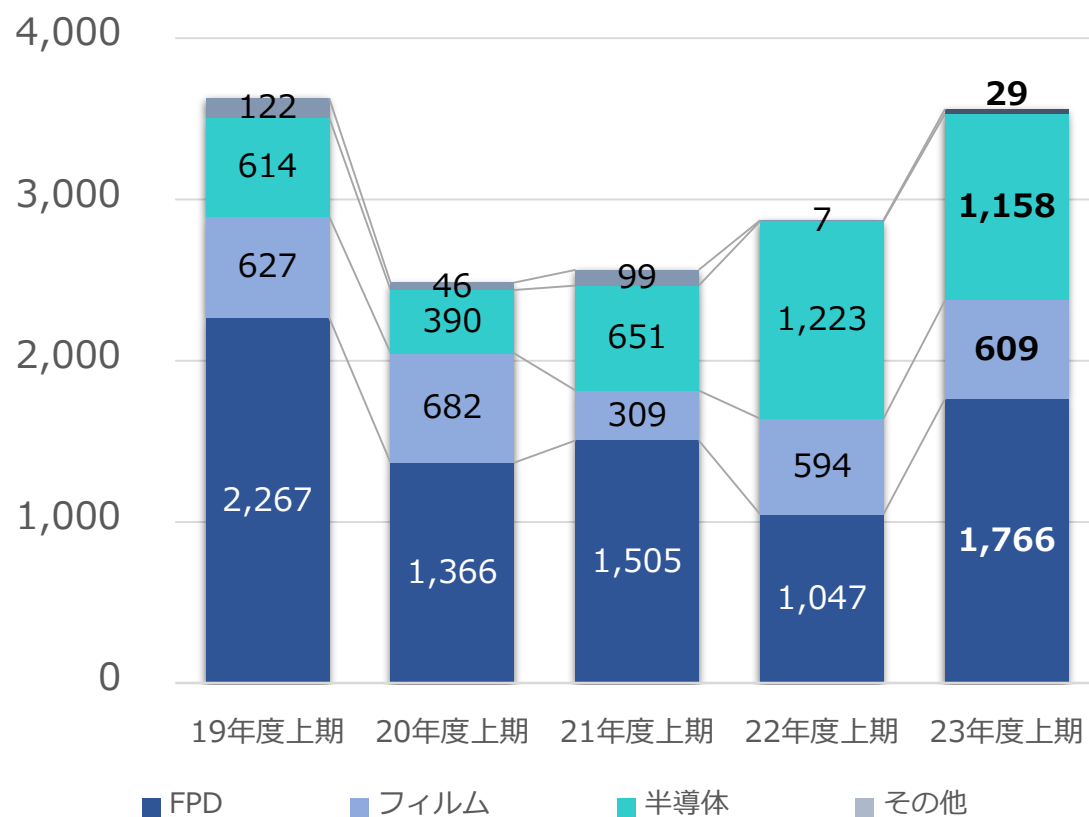
2023年度第2四半期 売上高構成比(単独)



検査計測装置(単独) 第2四半期売上高の推移

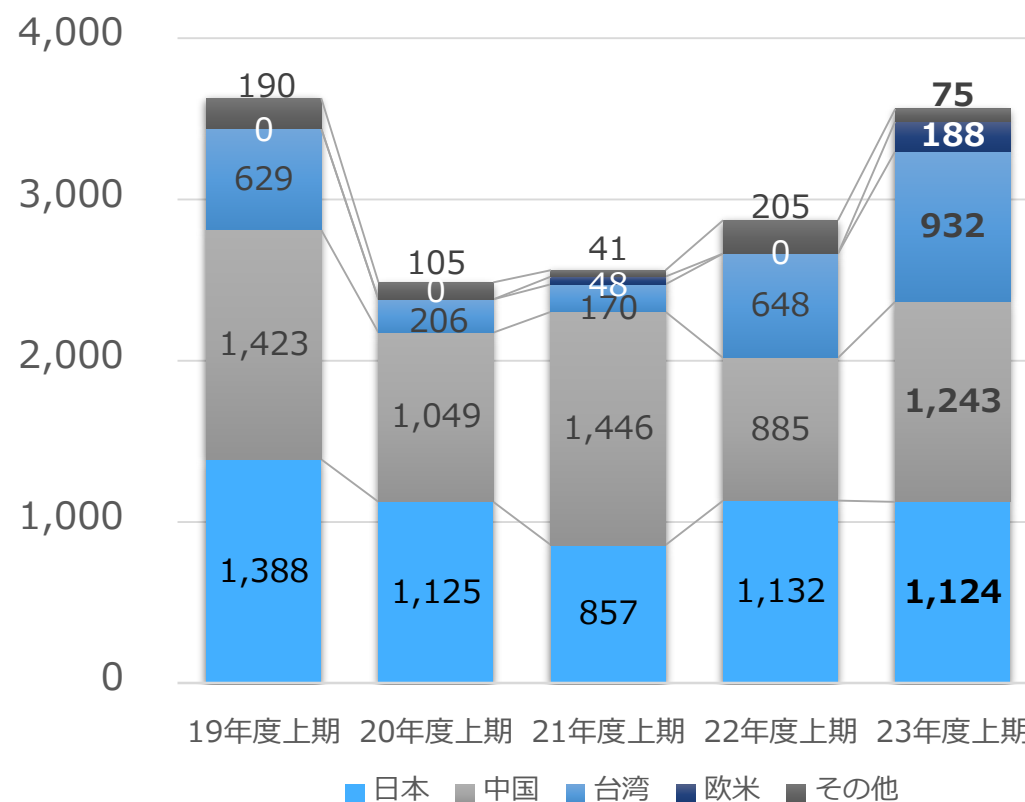
検査計測装置品目別売上高推移

単位：百万円



検査計測装置地域別売上高推移(単独)

単位：百万円



2023年度の通期予想（連結）について

2023年度通期予想（連結）

	2023年度通期予想 (百万円)	前年同期比 (%)	2022年度実績 (百万円)
売上高	25,900	112.4	23,037
営業利益	1,250	125.1	999
経常利益	1,400	126.9	1,103
親会社株主に帰属 する四半期純利益	1,000	120.6	828

トピックス

①長野県工業技術センターと共同開発した 新技術を公表（2023年6月5日）

タカノ株式会社と長野県工業技術総合センターは、
**半導体ウェハへ直接めっきできる、
新たな表面処理技術を開発しました。**

タカノ株式会社(宮田村)は、工業技術総合センター 精密・電子・航空技術部門(岡谷市)と、半導体ウェハ(シリコン)に直接めっきが可能となる、新たな表面処理技術を共同開発しました。

1 開発の背景

シリコンはミクロンサイズの半導体デバイスや MEMS[※]デバイスの材料であり、集積回路や加速度センサ等としてスマートフォンや自動車に使われています。これらのデバイスは配線や表面保護のため、シリコン表面へのめっきが必要な場合があります。しかし、シリコンは表面が酸化しやすく、直接めっきが困難な材料であり、任意の箇所にめっきを施すことも困難でした。

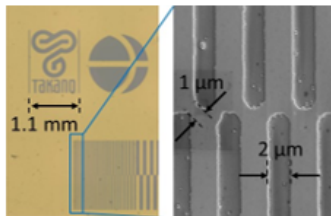
2 開発した技術の概要

シリコンの表面に合金層を形成することで、合金層の上のみめっきを析出する独自の技術を開発しました。合金層の形成を阻害する層を形成することで、線幅 1 μm 以下の微細な形状が実現可能です。立体構造物の側面のみめっきを析出させることで、耐折損強度を最大で3倍程度向上できます。

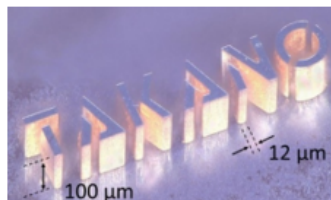
3 今後の展開

本技術は特許出願をしています。技術の高度化を進め、MEMS 関連商品の開発を行っていく予定です。

※ MEMS: 微小電気機械システムの略。電子回路と可動部を有する立体機械要素を1つのチップにまとめたシステム。



平面へ線幅 1~2 μm のめっき



立体構造体の側面へのめっき

②迅速アレルギー検査「Silis(サイリス)」 2023年11月1日に販売開始

既存事業であるファニチャー事業・画像計測事業・産業機器事業・医療福祉事業・エクステリア事業に加えて、新規事業として企業価値・社会貢献度の高い事業分野を模索してまいりました。その取り組みとして、体外診断用医薬品事業に注目し、現業技術の横断的な組み合わせと医療機関との連携によって体外診断薬測定システムの研究・開発を行ってまいりましたが、この度、迅速にアレルギー検査ができる体外診断用医薬品および測定するための測定機器の研究・開発を完了し、2023年6月5日に以下の2製品の届出および認証を受け2023年11月1日より販売開始いたしました。

①医療機器

商品名	自動分析装置SILIS-100<サイリス 100>
届出番号	20B2X10007TMD001

②体外診断用医薬品：特異的IgEおよび非特異的IgE測定試薬

商品名	検査キットSiLISアレルギー-45+1
認証番号	305ADEZX00040000



①自動分析装置SILIS-100<サイリス 100>

本製品は、食物系および吸入系アレルゲン45項目の特異的IgEおよび非特異的IgEの同時測定をすることを目的とした体外診断用医薬品です。アレルゲンを固定した反応チップと反応溶液を充填した試薬カートリッジに微量検体（血清又は血漿40 μL）を分注し、自動分析装置にセット後、15分で測定が完了します。主な測定項目としては食品表示法における「表示義務のある特定原材料」8品目の全品目、「特定原材料に準ずる推奨品目」20品目のうち17品目に対応しています。また、最近注目を集めている魚介類のアレルギー原因物質のひとつとされるアニサキスも搭載しています。生体におけるアレルギー反応の実態を把握するためには、アレルギー反応を引き起こす原因物質を特定することが重要ですが、同時に多くのアレルギー項目を迅速に検査する必要性が求められており、本製品は診療に携わる先生方の補助診断として、お役に立てるものと考えています。当社では、今後も臨床的に意義のある体外診断用医薬品の研究・開発を深め、予防医学の観点から、人々の健康づくりに貢献してまいります。



②SiLISアレルギー-45+1

2024年3月期 中間(単独) 検査計測機器 決算説明資料

取締役部門長 鷹野 雅央

2023年12月11日(月)

2024年3月期 検査計測機器 業績の内容について

(ご注意)

本資料は、検査計測機器の業績及び今後の経営戦略に関する情報の提供を目的としたものです。

本資料で開示されているデータは、発表日現在の判断や入手可能な情報に基づくものです。本資料で述べられている予測や見通しには、不確実な情報が含まれていることをご承知おきください。

1. セグメント報告

2. タカノ検査機器部門報告

1. 事業概況

2. 重点施策（半導体×海外展開）

3. 受注状況

1. セグメント報告

2. タカノ検査機器部門報告

1. 事業概況

2. 重点施策（半導体×海外展開）

3. 受注状況

検査計測機器のセグメント情報

	会社名	沿革	基本情報	事業の内容
加工・組立	タカノ機械株式会社 ※連結子会社 	1979年当社治工具・専用機の設計製造部門を分離独立させ設立	事業人員：約50名 拠点：宮田村	・省力化機械の製造販売 ・検査計測装置のメカ機械等の製作
調整・出荷	タカノ株式会社 検査計測部門 	1987年画像処理装置第1号機を完成	事業人員：約250名 拠点：全6拠点 ・信州南平工場 ・函館事業所 ・埼玉事業所 ・その他 営業拠点等	半導体や液晶・高機能フィルム用の検査計測装置等の製造販売
保守・改造	台湾鷹野股份有限公司 ※連結子会社 	2005年当社100%子会社として設立	事業人員：約15名 拠点：全2拠点 ・台中本社 ・桃園事務所	台湾におけるFPD向け画像処理検査装置のメンテナンス、アフターサービス、販売活動

2024年3月期 第2四半期 売上高

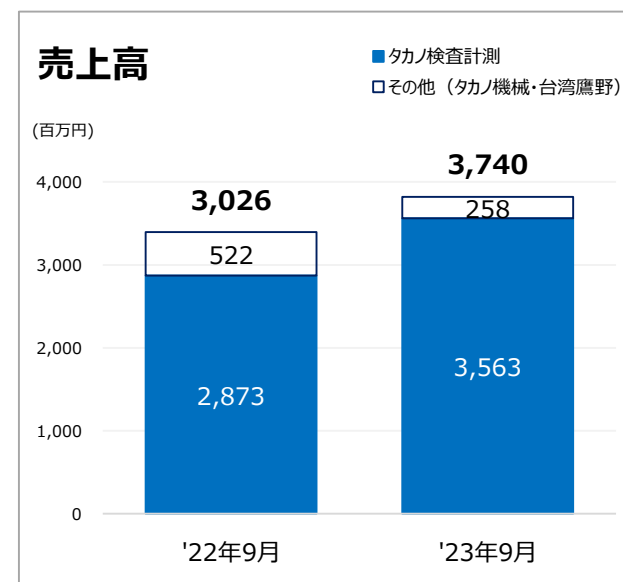
タカノ検査計測部門の売上拡大によりセグメント全体も増収 過年度受注分の液晶向け検査装置の売上計上が寄与

検査計測機器 売上高 (百万円)

	前期第2四半期 (2022年4-9月)	当期第2四半期 (2023年4-9月)	増減額	増減率 (%)
タカノ検査計測 ※1	2,873	3,563	690	24.0%
その他 ※1 (タカノ機械・台湾鷹野)	522	258	△264	△50.5%
調整額	△368	△81	—	—
連結売上高 ※2	3,026	3,740	713	23.6%

※1：タカノ検査計測及びその他の売上高は、セグメント間取引消去前の数値。

※2：連結売上高は、セグメント間取引消去後の数値。



2024年3月期 第2四半期 営業利益

検査機器セグメントでは黒字を確保するも低水準
半導体市場の停滞などの影響により下期偏重が顕著に

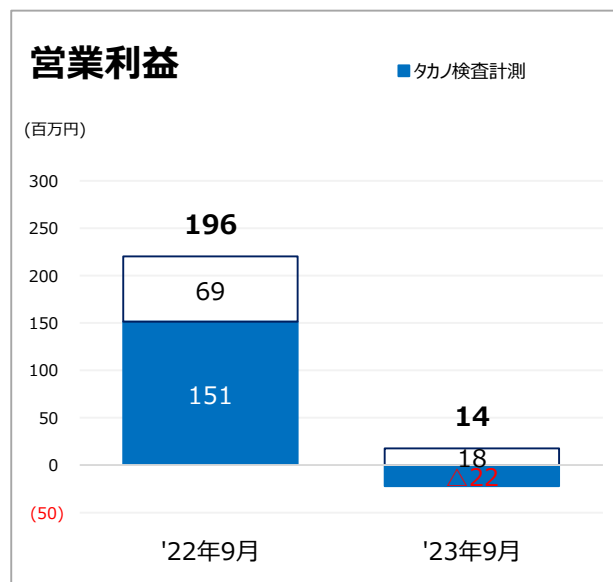
検査計測機器 営業利益 (百万円)

	前期第2四半期 (2022年4-9月)	当期第2四半期 (2023年4-9月)	増減額	増減率 (%)
タカノ検査計測 ※1・3	151	△22	△173	—
その他 ※1・3 (タカノ機械・台湾鷹野)	69	18	△51	△74.2%
調整額	△24	19	—	—
連結営業利益 ※2・3	196	14	△182	△92.5%

※1：タカノ検査計測及びその他の営業利益は、セグメント間取引消去前の数値。

※2：セグメント利益は、セグメント間取引消去後の数値。

※3：当期より報告セグメントの区分を変更しており、過年度も当該変更を反映した数値に組替え。



1. セグメント報告

2. タカノ検査機器部門報告

1. 事業概況

2. 重点施策（半導体×海外展開）

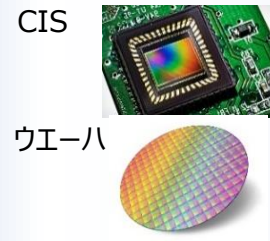
3. 受注状況

タカノ検査計測部門紹介 主要事業

半導体・電子デバイス事業 (以下「半導体事業」という)

ウエーハの異物や欠陥を高速、高精度に検出できる半導体検査装置

- Vi** — ウエーハの配線パターンやクラック、異物混入などの製品外観を高速、高精度に検査
- WM** — ベアウエーハ表面のパーティクルを高感度に検出
- ALTAX** — ウエーハやBGAなどのパッケージ基板上に形成されたバンプの高さ、径、コプラナティを高速かつ高精度に測定



WMシリーズ Viシリーズ ALTAX



※本資料における「半導体事業」は半導体と電子デバイスの合計を意味する。

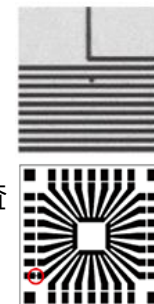
フィルム事業

ラインセンサーを用いた光学式のフィルム検査装置

高性能カメラによる高速検査が可能 新規画像処理ユニットを搭載し、高速画像転送とAI欠陥分類により、生産ラインの品質向上を実現する

参入市場：光学フィルム・電子部材・Energy・医療用フィルム

パターン検査



Hawk eyes



パッケージ検査



フラット・パネル・ディスプレイ事業 (以下「FPD事業」という)

色ムラ、欠陥等を高精細に検出できる液晶検査装置

テレビやスマートフォン用の液晶パネル製造工程でパターン付き基板の自動検査・欠陥判定をし、量産の品質工程管理を行う装置

参入市場：LCD(液晶ディスプレイ),PDP(プラズマディスプレイ),OLED(有機ELディスプレイ)

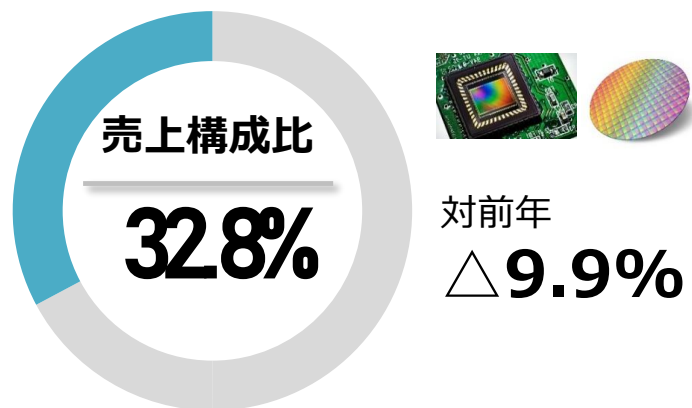


高精細外観検査装置 (カラーフィルター等) ムラ検査装置



2024年3月期 第2四半期 タカノ検査計測 売上構成

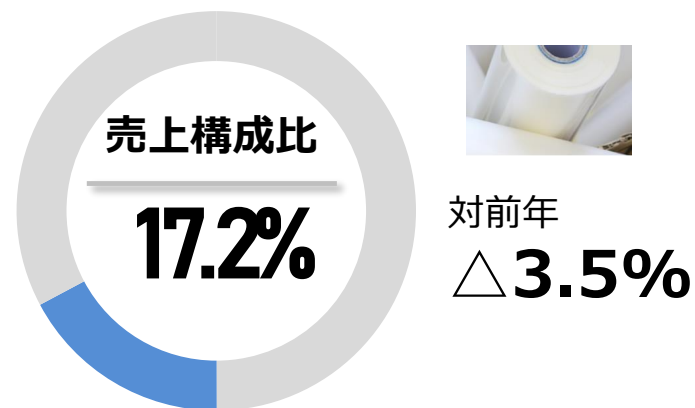
半導体事業



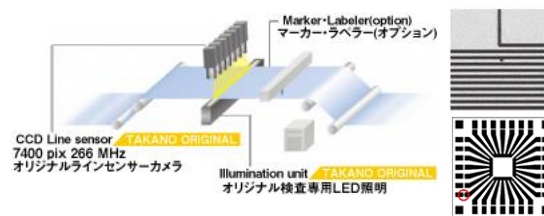
ウェーハの異物や欠陥を高速・高精度に検出できる半導体検査装置を提供



フィルム事業



ラインセンサーを用いた光学式のフィルム検査装置を提供



FPD事業

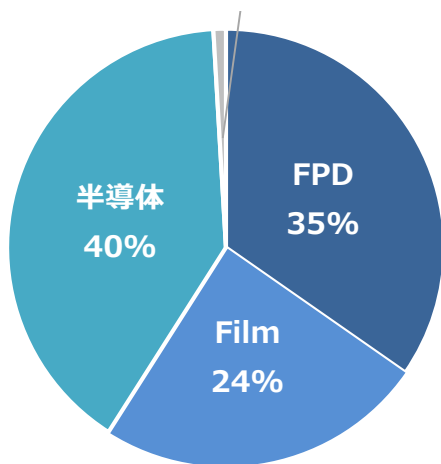


色ムラ、欠陥等を高精細に検出できる液晶検査装置を提供



2024年3月期 通期・第2四半期 タカノ検査計測 売上構成

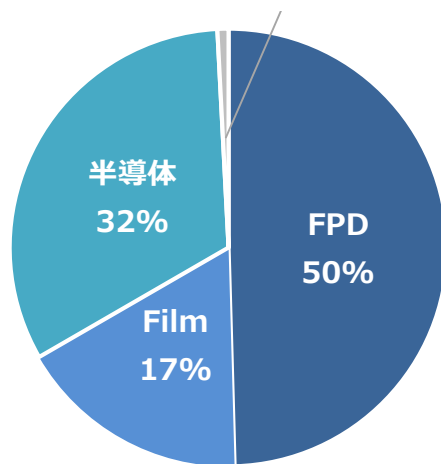
通期計画



①通期では半導体事業の構成比が全事業のなかで最大になる見込

②FPD事業は新規案件は縮小、FPD構成比の増加は一時的

第2四半期



①過年度受注のFPD案件の売上計上が重なる

②半導体市況の影響により売上計上時期が下期以降にずれ込む

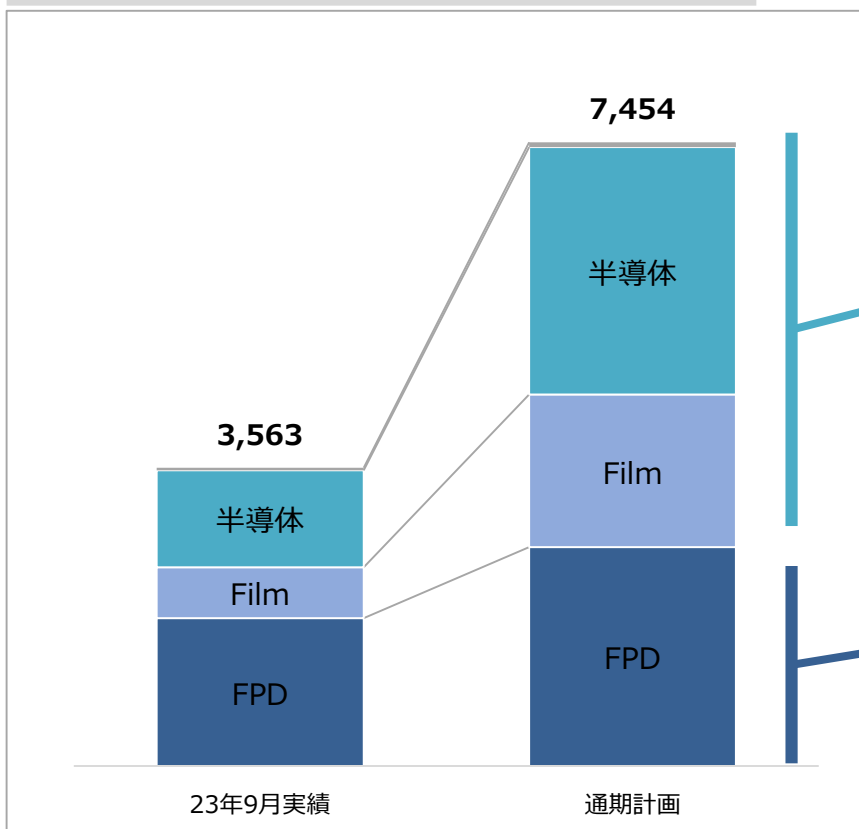
FPD構成比が高く、収益性を圧迫
※ただし一時的なもの

2024年3月期 売上計画・事業別方針

事業別に方針を明確化、期末に向けて事業構造転換を進める

高付加価値の半導体事業とFilm事業の拡大、グローバル展開を加速する

2024年3月期 売上高 推移・計画 (百万円)



半導体・Film

- 重点事業として積極拡大
- 海外市場開拓を進める(特に半導体)

FPD

- 選択的受注の実施(収益性重視)
- 構造見直し

1. セグメント報告

2. タカノ検査機器部門報告

1. 事業概況

2. 重点施策（半導体×海外展開）

3. 受注状況

2024年3月期 重点事業の商材

半導体・電子デバイス向け装置のラインナップ

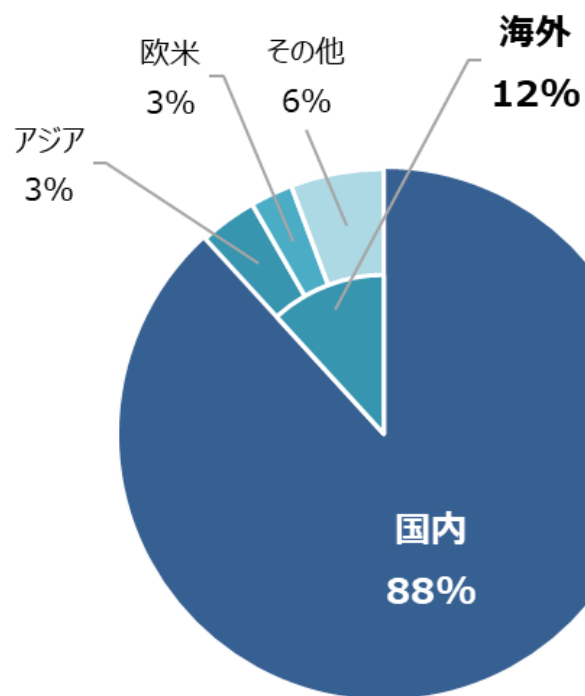
当社商品のラインナップ	製品名	製品説明	参入市場
1. WM  ウエーハ表面異物検査装置 販路拡大	 WM-10 ● 300mmウエーハの標準モデル ● 48nmの高感度検査システム	CMOS image sensor, POWER device, Bare-wafer, Filmed-wafer, RF filter, BUMP, MEMS	
	 WM-7SR 海外認証対応版 ● ウエーハサイズが200mm以下の最もリーズナブルな高性能モデル		
2. Vi ウエーハ外観検査装置	 Vi-4202R /4304C ウエーハの配線パターンやクラック、異物混入などの製品外観を高速、高精度に検査 ● ウエーハサイズ：200mm未満対応 ● ウエーハサイズ：300mm未満対応	半導体市場 Substrate市場	
3. ALTAX 高速バンプ高さ検査装置	 ALTAX-300EX 半導体チップの微細化や2.5Dや3Dパッケージ基板対応に向けた高速・高精細のバンプ高さ検査		
4. ThinSpector 全面膜厚ムラ検査装置	 半導体製造プロセスにおいて重要な膜厚管理を行う為にウエーハ全面の膜厚計測+膜厚Muraの検出を行う		

2024年3月期 第2四半期 最重点商材 WM売上高

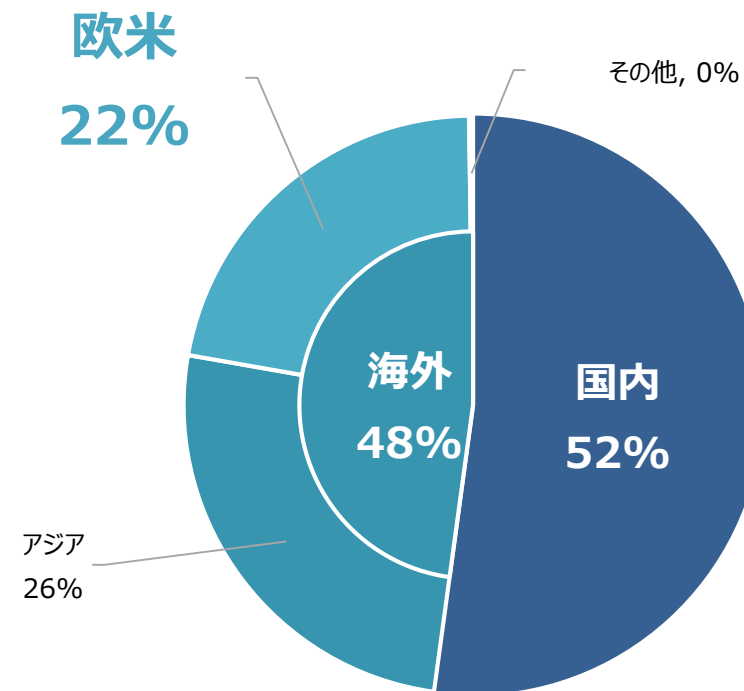
WMは国内売上高を維持し海外売上比率を欧米を中心に拡大

商社連携拡大、出展展示会の増加を通じて海外市場開拓を進める。海外市場で認知度を向上し、グローバル・ブランドの確立を目指す。

2022年3月期 WM売上高構成比



2023年9月 WM売上高構成比



1. セグメント報告

2. タカノ検査機器部門報告

1. 事業概況


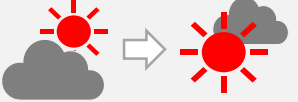

2. 重点施策（半導体×海外展開）

3. 受注状況

2024年3月期 第2四半期 市場動向

半導体市場 短期的には調整局面も、2024年以降の成長に期待

深刻な半導体不足から一転、需要調整局面に入り半導体世界市場は一旦落ち着きが見られる。
2024年以降、半導体市況は大幅な回復が予想され、メインターゲット市場であるパワー半導体などの非先端系半導体も安定成長が見込まれる。

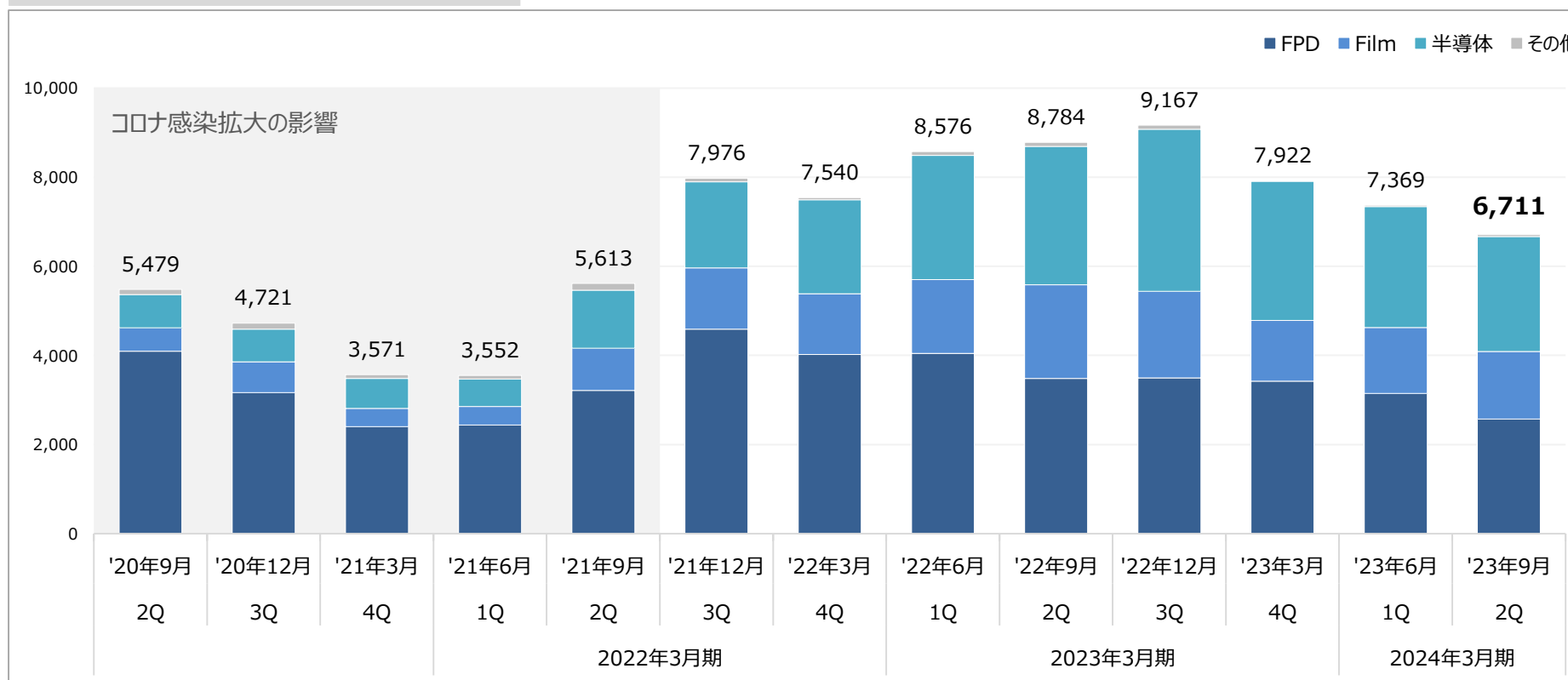
事業	マーケット状況 過去 現在	補足説明
半導体	 晴時々雲 → 曇	<ul style="list-style-type: none">● 車載（EV/自動運転）の需要増が見込まれる。● 半導体市況は来年以降の回復に大きな期待。 パワー半導体を中心に、引合いが増加傾向。
フィルム	 曇時々晴れ → 晴時々雲	<ul style="list-style-type: none">● 半導体の成長に牽引され、フィルムメーカーの投資が見込まれる。● バッテリー関連は、車載向けに継続的な成長が期待される。 半導体、電子デバイス向け基材メーカーからの受注・引合いが増加傾向。
フラット・パネル・ディスプレイ	 雨 → 雨	<ul style="list-style-type: none">● 主要顧客の生産は2022年秋より、なだらかな増産が継続中。 新規投資については慎重な状態が続く。● ニューノーマルの確立による新しいテクノロジー成長はスローペース。 (MicroLEDなどの引合い増加に期待)

2024年3月期 第2四半期 受注残高

半導体事業は高い水準で維持するもコロナ特需からの減速感

コロナ特需からの反動で減速感はみられるが、パワー半導体などの非先端系半導体は堅調で今後の需要拡大が見込まれる

事業別受注残高 (百万円)



2024年3月期 最重点商材 WMの成長戦略：販売

国内外の展示会で新規・潜在顧客へのアプローチを強化中 商社開拓を推進し、海外市場の販路拡大を継続



SEMICON West 2023

(米国サンフランシスコ)

欧米代理店Class Oneブースへ
WMポスターとデモ機出展



SEMICON EUROPA 2023

(ドイツ、ミュンヘン)

欧米代理店Class Oneブースへ
WMポスターとデモ機出展



4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月



SEMICON SEA 2023

(マレーシア、ペナン)

商社2社にWMポスター出展



SEMICON Taiwan 2023 (台北)

商社にポスター出展
WM、Vi、ALTAXなど



SEMICON Japan 2023

(東京ビックサイト)

12月13日～15日

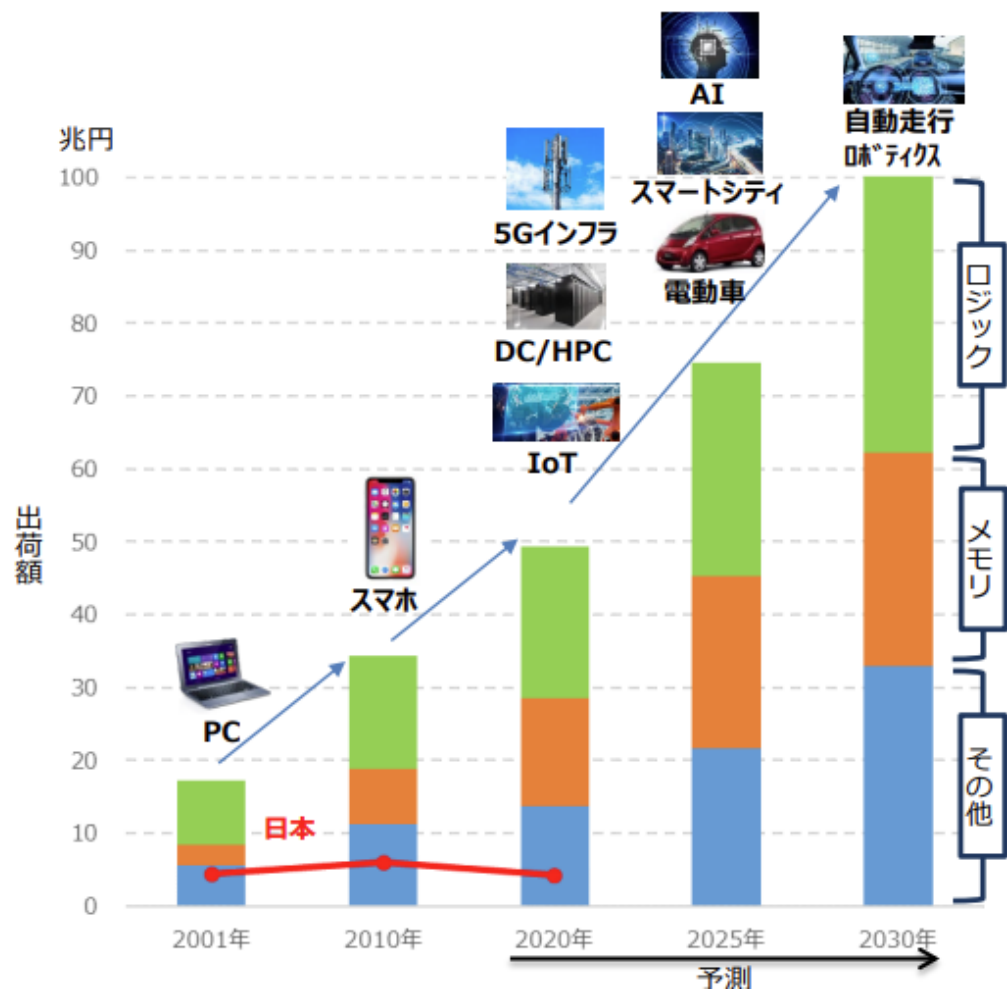
タカノ直接出展予定
WM、Vi、ALTAXなど



展示ブースイメージ

中長期の半導体市場想定

半導体市場の概況 (出典) Omdiaのデータを基に経済産業省作成「半導体戦略 (概略) 2021.6」



	市場規模 2018年	製品例	主要企業
ロジック (制御用)	21兆円	プロセッサ	intel tsmc
		GPU	QUALCOMM NVIDIA
		SoC	
メモリ (データ記憶用)	18兆円	DRAM	SAMSUNG SK hynix
		NAND	Micron KIOXIA
その他	15兆円	アナログLSI	Infineon SONY
		パワー半導体	ON Semiconductor MITSUBISHI ELECTRIC
		イメージセンサ	

END
(検査計測機器)

※この資料に記載されている業績予想等の将来に関する予測は、当社経営陣が現時点で入手可能な情報に基づき、判断したものです。

将来に関する予想には様々な潜在的リスクや不確定要素が内在されており、実際の業績は種々の要素によりこれらの将来予想とは異なる場合があります。

従いまして、この資料にある将来に関する予想に全面的に依存して投資等の判断を行うことはお差し控えください。